

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 8 月 11 日 (11.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/074029 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 25/04, 25/18  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000642  
(22) 国際出願日: 2005 年 1 月 20 日 (20.01.2005)  
(25) 国際出願の言語: 日本語  
(26) 国際公開の言語: 日本語  
(30) 優先権データ:  
特願2004-019584 2004 年 1 月 28 日 (28.01.2004) JP  
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電  
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-  
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大  
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).  
(72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中谷 誠一  
(NAKATANI, Seichi). 三谷 力 (MITANI, Tsutomu).  
(74) 代理人: 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナ  
ーズ (IKEUCHI SATO & PARTNER PATENT ATTOR-  
NEYS); 〒5306026 大阪府大阪市北区天満橋 1 丁目  
8 番 3 0 号 O A P タワー 2 6 階 Osaka (JP).

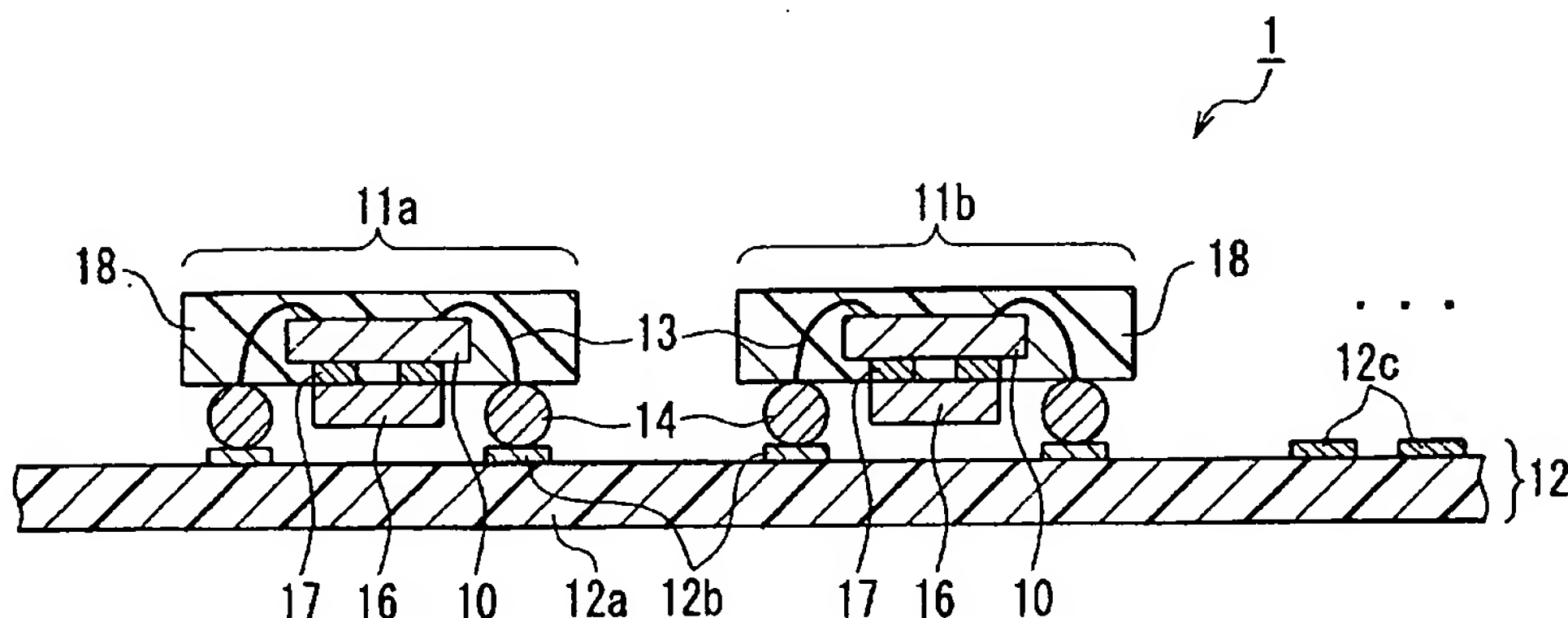
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,  
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,  
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.  
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護  
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,  
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,  
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,  
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,  
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: MODULE AND MOUNTING STRUCTURE USING THE SAME

(54) 発明の名称: モジュール及びこれを用いた実装構造体



(57) Abstract: There is provided a module capable of reducing the size and the manufacturing cost as well as eliminating the affect of electromagnetic noise. There is also provided a mounting structure using the module. The module (1) includes a plurality of semiconductor packages (11a, 11b) each having a substrate (12) and a semiconductor chip (10) mounted on the substrate (12). Each of the semiconductor packages (11a, 11b) includes a first radio communication element (16) for performing transmission/reception of a signal between the semiconductor chips (10) of the semiconductor packages (11a, 11b) by radio communication. The first radio communication element (16) is configured independently of the semiconductor chip (10).

(57) 要約: 小型化及び製造コストの低減が可能な上、電磁波ノイズの影響を受け難いモジュールとこれを用いた実装構造体を提供する。基板(12)と、基板(12)に実装された、半導体チップ(10)をそれぞれ含む複数の半導体パッケージ(11a, 11b)とを有し、複数の半導体パッケージ(11a, 11b)のそれぞれは、複数の半導体パッケージ(11a, 11b)間における半導体チップ(10)同士の信号の送受信を無線通信で行う第1無線通信素子(16)を含み、第1無線通信素子(16)は半導体チップ(10)と独立して構成されているモジュール(1)とする。



2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。